



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091005002
2009 年 10 月 27 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

CC1070 一部製品 組立サイト追加変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

記

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		■Final notice	
変更概要	■Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	■Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	■Assembly	■Site	■Process	■Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	CC1070 一部製品 組立サイト追加変更 現行 : AMS 社(オーストリア) 変更後 : AMS 社(オーストリア)、TI-Malaysia(マレーシア)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2010 年 1 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画		■終了	
製品表示	☐ 変更無し		■変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) CC1070 一部製品の組立サイトについて、現行 AMS社 (オーストリア) サイトにて製造しておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Malaysia (マレーシア) サイトでの製造を追加し認定しました。組立部材、パッケージ寸法の違いについては下記詳細を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立サイト	AMS社 (オーストリア)	AMS社 (オーストリア) TI-Malaysia (マレーシア)

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名		
CC1070RGW	CC1070RSQ	CC1070-RTR1
CC1070RGWR	CC1070RSQR	CC1070-RTY1

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地 (ラベル箇所: 22L, 23L) 及び製品捺印が下記のようになります。

	組立サイト	組立サイトコード (22L)	組立国コード (23L)
現行	AMS	AUS	AUT
追加認定	TI-Malaysia	MLA	MYS



図1 出荷ラベルの例

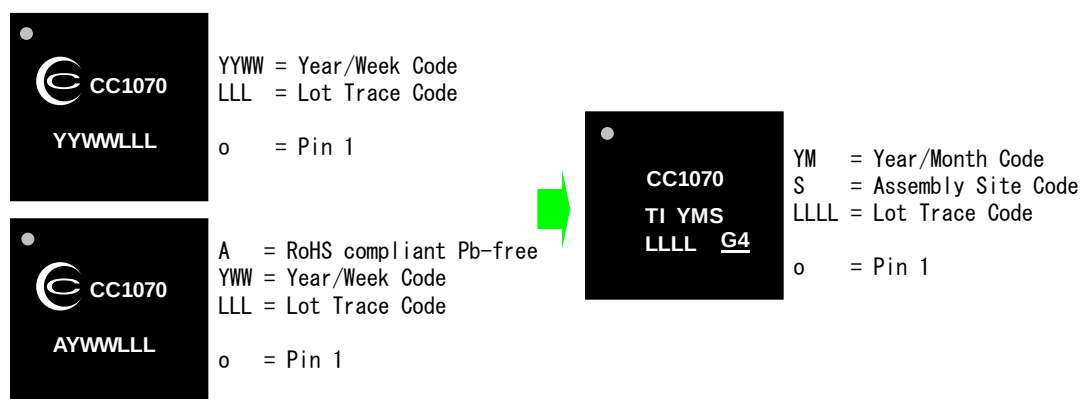


図2 製品捺印の例

詳細：

	現行	変更後
Assembly Site	AMS	MLA
Package Type	RSQ	RGW
Lead Frame	CDA194	13 LF= 4205922-0001 (Downbonds)
Lead finish	Sn/Pb	NiPdAu
Mold Compound	4205867	4208625
Bond Wire	1 mil (25.4 μ m)	0.96 mils (24.3 μ m)

表 1 組立部材比較

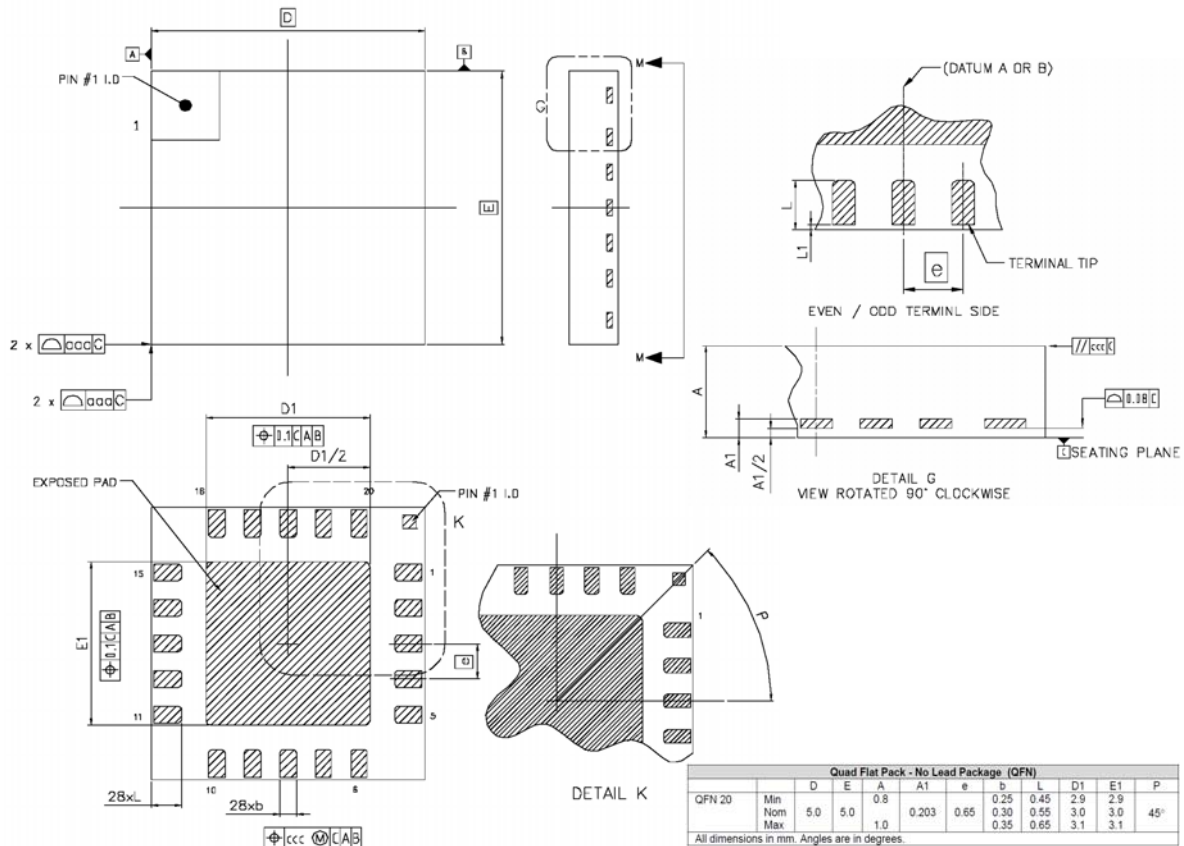


図 3 現行パッケージ寸法図 (パッケージコード：RSQ)

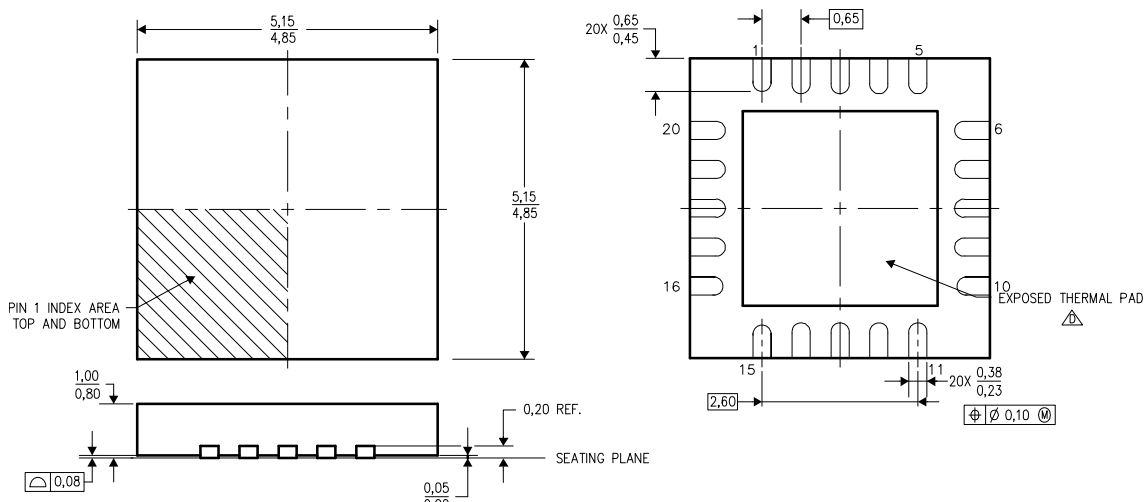


図 4 変更後パッケージ寸法図 (パッケージコード：RGW)

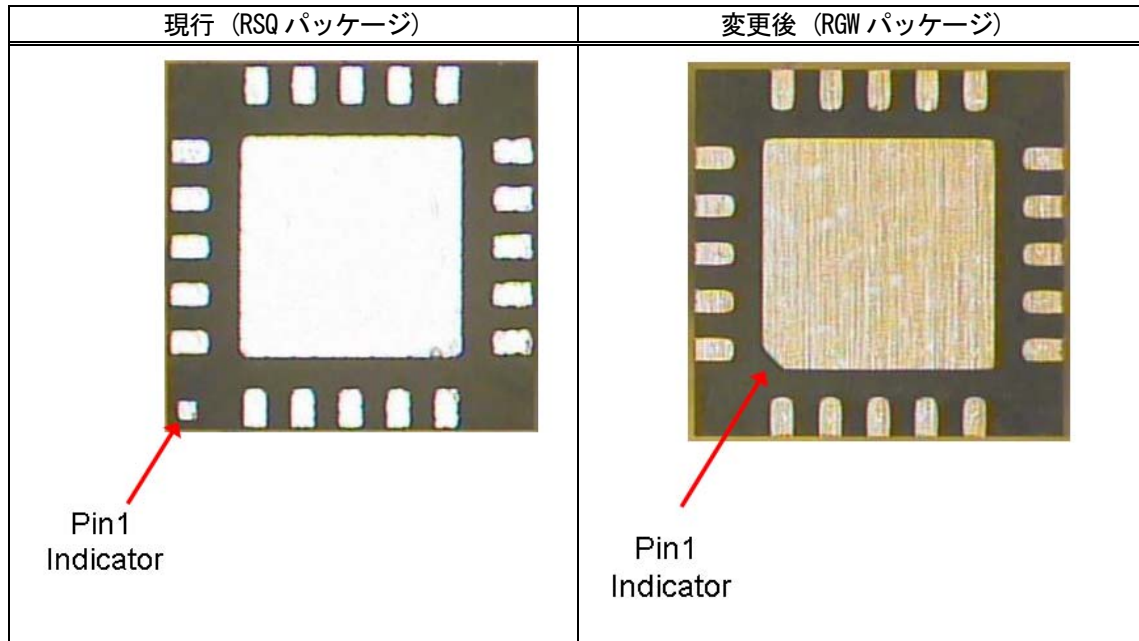


図5 Pin1 表示比較 (パッケージ裏面/端子側)

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 8 月 17 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CC1070RGW	Die Size (mm):	1.955 X 2.120	
Die Protective Coating:	10KACN		-	-
Assembly Site:	MLA	Package/Code/Pins:	QFN/RGW/20	
Mount Compound:	4205846	Mold Compound:	4208625	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia. Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC LEVEL-3 / 260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
Electrical Char.	Full Temp	Pass	Pass	Pass
**Autoclave	121C, 96 Hrs.	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
X-Ray	Topside	5/0	5/0	5/0
Thermal Path Integrity	192Hrs,30C / 60%	12/0	12/0	-
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77/0	-	-
ESD CDM	3 units / level, 150V, 250V, 500V	9/0	-	-
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Pass	-	-
Notes: ** Must be preconditioned per the appropriate sequence, JEDEC L-3 / 260C				